



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月7日

上場会社名 大日本スクリーン製造株式会社
コード番号 7735 URL <http://www.screen.co.jp/>

上場取引所 東大

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 橋本 正博

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 太田 祐史

TEL 075-414-7155

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	123,021	11.4	9,000	△18.5	8,815	△19.6	6,531	△31.9
23年3月期第2四半期	110,405	63.8	11,043	—	10,968	—	9,584	—

(注)包括利益 24年3月期第2四半期 3,423百万円 (△29.0%) 23年3月期第2四半期 4,819百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	27.51	—
23年3月期第2四半期	40.37	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	254,079		89,828			35.2
23年3月期	253,126		87,600			34.4

(参考)自己資本 24年3月期第2四半期 89,362百万円 23年3月期 87,118百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	—	—	5.00	5.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	249,000	△2.3	14,000	△47.8	13,000	△51.0	10,000	△61.1	42.13

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
詳細は、[添付資料]3ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期2Q	253,974,333 株	23年3月期	253,974,333 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	16,602,220 株	23年3月期	16,598,341 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	237,373,695 株	23年3月期2Q	237,393,776 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 平成23年8月9日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。
2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
3. 当社は、平成23年11月8日(火)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料およびその説明内容は、開催後当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) セグメント情報等	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 決算補足資料	11
(1) 連結決算の概要	11
(2) 事業別連結売上高	12
(3) 事業別連結受注状況	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成23年4月1日～9月30日)における世界経済は、中国など新興国では内需拡大を背景に景気は底堅く推移したものの、欧州の債務問題や米国の景気低迷などにより、世界的な景気減速懸念が高まりました。わが国経済では、東日本大震災の影響により混乱していたサプライチェーンの修復が急速に進み、持ち直しの動きも見られましたが、円高や海外経済の減速が企業活動に影響を及ぼすなど、予断を許さない状況が続きました。

当社を取り巻く事業環境では、半導体業界において、スマートフォンやタブレット型端末などの需要増加を背景に、半導体メーカーの設備投資が前年同期に比べ増加しました。しかしながら、半導体製品の需給バランスの悪化に加え、世界的な景気減速懸念の高まりにより、期間の後半には半導体メーカーにおいて設備投資抑制の動きが顕著となりました。

このような状況のなか、当第2四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、主に半導体機器事業が伸長したことにより、売上高は1,230億2千1百万円と前年同期に比べ126億1千5百万円(11.4%)増加しました。利益面では、製品販売価格の下落や研究費・人件費などの増加により、営業利益は90億円(前年同期比18.5%減)、経常利益は88億1千5百万円(前年同期比19.6%減)となりました。また、特別損失において保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損を計上したことなどにより、四半期純利益は65億3千1百万円(前年同期比31.9%減)となりました。

セグメント別の業績概況は以下のとおりです。

(半導体機器事業：SE)

半導体機器事業では、半導体メーカーの設備投資増加を受け、枚葉式洗浄装置を中心に半導体製造装置の売上が前年同期に比べ増加しました。地域別では、アジア向けは減少しましたが、国内向けや米国向けが増加しました。その結果、当セグメントの売上高は844億1千8百万円(前年同期比21.8%増)となりました。利益面につきましては、製品販売価格の下落や研究費・人件費などの増加により、営業利益は93億3千9百万円(前年同期比15.8%減)となりました。

(FPD機器事業：FE)

FPD機器事業では、パネルメーカーの設備投資が低調であったため、FPD製造装置の売上が前年同期に比べ減少しました。その結果、当セグメントの売上高は144億4百万円(前年同期比17.5%減)、営業損失は10億5千9百万円(前年同期は6億5千3百万円の営業利益)となりました。

(メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業：MP)

メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業では、印刷関連機器は、国内向けは低調であったものの北米向けにPOD装置が伸び、前年同期に比べ売上が増加しました。プリント配線板関連機器は、関連メーカーの設備投資が低調となり、前年同期に比べ売上が減少しました。その結果、当セグメントの売上高は238億7千4百万円(前年同期比2.3%増)となりました。利益面につきましては、コストダウンや固定費圧縮に努めたことにより、営業利益は10億3千6百万円(前年同期は7億6千2百万円の営業損失)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛金の減少、社債発行に伴う現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ9億5千3百万円(0.4%)増加し2,540億7千9百万円となりました。

負債合計は、支払手形及び買掛金や1年内返済予定の長期借入金の減少、社債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ12億7千5百万円(0.8%)減少し1,642億5千万円となりました。有利子負債につきましては、借換え資金として190億円の社債を発行したことなどにより、前連結会計年度末に比べ141億8千8百万円(25.5%)増加し697億7千8百万円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、前連結会計年度末に比べ6億9千2百万円(4.4%)増加し162億9千6百万円となりました。

純資産の部では、配当金の支払の一方で、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加し、また、保有株式の時価下落および円高により、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定がそれぞれ減少しました。その結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ22億2千8百万円(2.5%)増加し898億2千8百万円となりました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の34.4%から0.8ポイント改善し35.2%となりました。なお、平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本剰余金が255億7千1百万円減少し、利益剰余金が同額増加しております。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少などの収入項目が、仕入債務の減少、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出項目を上回り、28億2千万円の収入（前年同期は151億5千5百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、土地等の有形固定資産を売却した一方で、有形固定資産や子会社株式の取得を行った結果、7億5千5百万円の支出（前年同期は4億2千3百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや長期借入金、リース債務の返済の一方で、社債発行を行った結果、126億9千3百万円の収入（前年同期は57億1千7百万円の支出）となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ133億3千万円増加し、517億1千3百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済環境は、欧州の債務問題や米国の景気低迷の世界経済への波及に加え、新興国での物価上昇に伴う景気下振れリスクやタイの洪水によるサプライチェーンへの影響も懸念されるなど、当面、予断を許さない状況が続くものと見込まれます。

当社を取り巻く事業環境では、半導体最終製品の需要減速や世界的な景気減速懸念の高まりを受け、半導体メーカーでは引き続き設備投資に慎重な姿勢をとることが予想されます。

このような環境のもと、平成24年3月期の通期連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の業績および現在の受注動向等から、主に半導体機器事業の売上・利益が前回予想を下回る見込みとなりました。平成23年8月9日に公表した連結業績予想では、事業環境を見極めることが困難であったため下半期の予想を見直さず据え置きとさせていただいておりましたが、上記を踏まえ、平成24年3月期の通期連結業績予想を以下のとおり修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

〔平成24年3月期連結業績予想〕

		通 期
売 上 高		2,490 億円
	S E	1,654
	F E	335
	M P	495
	その他	6
営 業 利 益		140
経 常 利 益		130
当 期 純 利 益		100

※セグメント間取引は、相殺消去しております。

(注)上記業績予想の前提となる第3四半期以降の為替レートは1米ドル=75円、1ユーロ=105円を想定しております。なお、業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、主として当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	39,985	53,482
受取手形及び売掛金	70,979	62,742
商品及び製品	25,307	26,798
仕掛品	31,301	29,269
原材料及び貯蔵品	4,604	5,359
繰延税金資産	7,612	7,533
その他	4,739	3,902
貸倒引当金	△1,007	△1,015
流動資産合計	183,522	188,073
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	53,265	51,526
機械装置及び運搬具	29,019	29,172
その他	28,316	27,918
減価償却累計額	△69,901	△69,214
有形固定資産合計	40,699	39,401
無形固定資産		
その他	1,189	1,866
無形固定資産合計	1,189	1,866
投資その他の資産		
投資有価証券	22,184	19,057
その他	5,601	5,836
貸倒引当金	△71	△155
投資その他の資産合計	27,715	24,737
固定資産合計	69,604	66,006
資産合計	253,126	254,079

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	81,942	71,090
短期借入金	500	1
1年内返済予定の長期借入金	35,060	29,652
1年内償還予定の社債	2,500	2,500
リース債務	2,026	1,709
未払法人税等	2,242	1,592
設備関係支払手形	49	251
役員賞与引当金	68	28
製品保証引当金	6,059	5,889
受注損失引当金	336	339
資産除去債務	32	—
その他	17,313	13,976
流動負債合計	148,131	127,031
固定負債		
社債	7,000	26,000
長期借入金	3,633	5,953
リース債務	4,869	3,961
退職給付引当金	279	380
役員退職慰労引当金	110	125
資産除去債務	48	48
その他	1,453	748
固定負債合計	17,394	37,218
負債合計	165,526	164,250
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,044	54,044
資本剰余金	30,154	4,583
利益剰余金	26,418	57,333
自己株式	△12,236	△12,239
株主資本合計	98,381	103,722
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,344	112
繰延ヘッジ損益	△41	△21
為替換算調整勘定	△12,566	△14,451
その他の包括利益累計額合計	△11,263	△14,360
少数株主持分	482	466
純資産合計	87,600	89,828
負債純資産合計	253,126	254,079

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	110,405	123,021
売上原価	78,260	90,143
売上総利益	32,144	32,877
販売費及び一般管理費	21,101	23,877
営業利益	11,043	9,000
営業外収益		
受取利息	35	48
受取配当金	159	229
持分法による投資利益	429	—
固定資産売却益	170	378
その他	413	345
営業外収益合計	1,207	1,001
営業外費用		
支払利息	938	743
為替差損	79	35
その他	265	407
営業外費用合計	1,282	1,185
経常利益	10,968	8,815
特別利益		
貸倒引当金戻入額	156	—
その他	2	0
特別利益合計	158	0
特別損失		
投資有価証券評価損	198	1,212
災害による損失	—	18
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	297	—
その他	—	5
特別損失合計	496	1,236
税金等調整前四半期純利益	10,629	7,578
法人税等	1,084	1,065
少数株主損益調整前四半期純利益	9,544	6,513
少数株主損失(△)	△39	△17
四半期純利益	9,584	6,531

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	9,544	6,513
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,425	△1,232
繰延ヘッジ損益	△0	20
為替換算調整勘定	△2,299	△1,878
その他の包括利益合計	△4,725	△3,090
四半期包括利益	4,819	3,423
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,864	3,434
少数株主に係る四半期包括利益	△45	△10

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	10,629	7,578
減価償却費	2,903	2,435
持分法による投資損益(△は益)	△429	2
投資有価証券評価損益(△は益)	198	1,212
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△82	100
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△5	△39
製品保証引当金の増減額(△は減少)	389	△137
受注損失引当金の増減額(△は減少)	△230	3
受取利息及び受取配当金	△194	△277
支払利息	938	743
売上債権の増減額(△は増加)	△4,725	8,431
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12,818	△1,716
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△248	282
仕入債務の増減額(△は減少)	18,772	△10,671
未払費用の増減額(△は減少)	△92	△631
その他の流動負債の増減額(△は減少)	1,814	△2,673
その他	△7	△230
小計	16,811	4,412
利息及び配当金の受取額	196	290
利息の支払額	△941	△739
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△868	△57
法人税等の支払額	△41	△1,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,155	2,820
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△43	△191
有形固定資産の取得による支出	△559	△1,265
有形固定資産の売却による収入	288	1,363
投資有価証券の取得による支出	△6	△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△313
その他	△101	△341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△423	△755
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	△497
長期借入れによる収入	—	3,000
長期借入金の返済による支出	△3,686	△6,259
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,025	△1,250
社債の発行による収入	—	18,895
自己株式の純増減額(△は増加)	△1	△2
配当金の支払額	—	△1,186
少数株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,717	12,693
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,481	△1,426
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	7,533	13,330
現金及び現金同等物の期首残高	29,904	38,383
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,438	51,713

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント(注1)				その他 (注2)	合計	調整額 (注3)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注4)
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	69,288	17,456	23,340	110,085	319	110,405	—	110,405
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	3,647	3,647	△3,647	—
計	69,288	17,456	23,340	110,085	3,967	114,053	△3,647	110,405
セグメント利益 又は損失(△)	11,095	653	△762	10,985	162	11,148	△104	11,043

(注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント配線板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

3 セグメント利益又は損失(△)の調整額△104百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント(注1)				その他 (注2)	合計	調整額 (注3)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注4)
	SE	FE	MP	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	84,418	14,404	23,874	122,697	324	123,021	—	123,021
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	—	—	4,239	4,239	△4,239	—
計	84,418	14,404	23,874	122,697	4,563	127,260	△4,239	123,021
セグメント利益 又は損失(△)	9,339	△1,059	1,036	9,316	△40	9,275	△275	9,000

(注) 1 SEは、半導体製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。FEは、FPD製造装置の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。MPは、印刷関連機器およびプリント配線板関連機器の開発、製造、販売および保守サービスを行っております。

2 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発、印刷物の企画・製作、物流業務等の事業を含んでおります。

3 セグメント利益又は損失(△)の調整額△275百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成23年4月22日開催の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」が承認可決されたことにより、資本準備金を26,636百万円減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えております。また、増加後のその他資本剰余金を25,571百万円、別途積立金を28,500百万円減少し、それぞれ繰越利益剰余金に振り替えております。この結果、資本剰余金が25,571百万円減少し、利益剰余金が25,571百万円増加しております。

4. 決算補足資料

(1) 連結決算の概要

(百万円未満切捨、その他は単位未満四捨五入)

	23年3月期	24年3月期	対前期比		23年3月期	24年3月期
	第2四半期実績	第2四半期実績	増減額	増減率	実績	通期予想
売上高	110,405	123,021	+12,615	+11.4%	254,952	249,000
営業利益	11,043	9,000	△2,043	△18.5%	26,811	14,000
(営業利益率)	10.0%	7.3%	△2.7 pt	—	10.5%	5.6%
経常利益	10,968	8,815	△2,152	△19.6%	26,531	13,000
(経常利益率)	9.9%	7.2%	△2.7 pt	—	10.4%	5.2%
当期純利益	9,584	6,531	△3,053	△31.9%	25,686	10,000
(当期純利益率)	8.7%	5.3%	△3.4 pt	—	10.1%	4.0%
総資産	234,039	254,079	★ +953	+0.4%	253,126	—
純資産	69,854	89,828	★ +2,228	+2.5%	87,600	—
自己資本	69,469	89,362	★ +2,244	+2.6%	87,118	—
自己資本比率	29.7%	35.2%	★ +0.8 pt	—	34.4%	—
1株当たり純資産	292.63円	376.47円	★ +9.47円	+2.6%	367.00円	—
有利子負債	71,989	69,778	★ +14,188	+25.5%	55,590	—
純有利子負債	33,293	16,296	★ +692	+4.4%	15,604	—
営業キャッシュ・フロー	15,155	2,820	—	—	34,299	—
投資キャッシュ・フロー	△423	△755	—	—	△2,191	—
財務キャッシュ・フロー	△5,717	12,693	—	—	△22,249	—
減価償却額	2,903	2,435	△467	△16.1%	5,805	5,600
設備投資額	1,190	2,228	+1,038	+87.3%	3,612	10,000
研究開発費	5,738	6,544	+805	+14.0%	12,129	15,000
グループ従業員数	4,701人	4,889人	★ +157人	+3.3%	4,732人	—
連結子会社数	45社	44社	★ +1社	—	43社	—
(国内)	(19社)	(20社)	★ (+1社)	—	(19社)	—
(海外)	(26社)	(24社)	★ (—社)	—	(24社)	—
関連会社数	2社	1社	★ —社	—	1社	—
(内持分法適用会社数)	(2社)	(1社)	★ (—社)	—	(1社)	—

★は対前期末(23年3月期)増減

(2) 事業別連結売上高

(単位：百万円)

		23年3月期						24年3月期				
		第1四半期 実績	第2四半期 実績	第2四半期 累計期間実績	第3四半期 実績	第4四半期 実績	通期実績	第1四半期 実績	第2四半期 実績	第2四半期 累計期間実績	通期予想	
半導体機器事業	国内	4,857	5,563	10,420	5,351	8,607	24,380	8,668	13,159	21,827	—	
	海外	27,922	30,945	58,867	44,156	46,873	149,898	39,571	23,019	62,590	—	
	計	32,779	36,509	69,288	49,508	55,481	174,278	48,239	36,178	84,418	165,400	
FPD機器事業	国内	316	4,031	4,347	864	1,615	6,828	383	2,194	2,577	—	
	海外	7,893	5,215	13,109	5,305	7,468	25,882	4,717	7,109	11,827	—	
	計	8,210	9,246	17,456	6,170	9,083	32,711	5,100	9,303	14,404	33,500	
メディアアンドプレジジョン テクノロジー事業	国内	4,548	6,555	11,104	3,761	5,908	20,773	4,077	5,449	9,526	—	
	海外	5,759	6,476	12,236	6,617	7,679	26,532	6,991	7,356	14,347	—	
	計	10,307	13,032	23,340	10,378	13,588	47,306	11,068	12,806	23,874	49,500	
	うち印刷関連機器	国内	4,007	5,044	9,051	3,495	4,904	17,452	3,328	4,808	8,136	—
		海外	4,950	5,603	10,553	5,754	6,727	23,035	6,246	6,594	12,840	—
	計	8,958	10,647	19,605	9,250	11,632	40,488	9,574	11,403	20,977	43,200	
うちプリント配線板関連機器	国内	540	1,511	2,052	265	1,003	3,321	749	640	1,389	—	
	海外	809	873	1,682	862	951	3,496	744	762	1,507	—	
計	1,349	2,385	3,734	1,128	1,955	6,818	1,493	1,402	2,896	6,300		
その他	国内	122	193	315	151	179	646	138	174	313	—	
	海外	3	1	4	5	0	10	4	6	11	—	
	計	125	194	319	157	179	656	142	181	324	600	
合 計	国内	9,844	16,343	26,187	10,128	16,311	52,628	13,267	20,977	34,244	—	
	海外	41,578	42,639	84,217	56,084	62,021	202,324	51,284	37,492	88,776	—	
	計	51,422	58,982	110,405	66,213	78,333	254,952	64,551	58,470	123,021	249,000	
	海外比率	80.9%	72.3%	76.3%	84.7%	79.2%	79.4%	79.4%	64.1%	72.2%	—	

(3) 事業別連結受注状況

(単位：百万円)

		23年3月期 第2四半期 (平成22年7月～9月)		23年3月期 第3四半期 (平成22年10月～12月)		23年3月期 第4四半期 (平成23年1月～3月)		24年3月期 第1四半期 (平成23年4月～6月)		24年3月期 第2四半期 (平成23年7月～9月)		
		受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	
半導体機器事業	国内	4,958	7,941	10,815	13,404	8,275	13,071	10,005	14,407	6,552	7,799	
	海外	44,051	68,463	34,571	58,878	45,458	57,462	29,129	47,020	26,266	50,267	
	計	49,008	76,404	45,386	72,282	53,732	70,533	39,134	61,427	32,818	58,066	
FPD機器事業	国内	1,658	1,624	1,738	2,497	5,670	6,551	1,129	7,296	778	5,881	
	海外	7,022	25,263	4,698	24,655	3,808	20,995	5,024	21,301	1,939	16,131	
	計	8,680	26,887	6,435	27,152	9,477	27,546	6,152	28,597	2,718	22,011	
メディアアンドプレジジョン テクノロジー事業	国内	5,588	1,551	4,346	2,136	5,852	2,080	3,550	1,552	4,937	1,040	
	海外	5,178	2,788	6,427	2,597	7,163	2,080	9,400	4,489	6,227	3,359	
	計	10,766	4,339	10,773	4,734	13,015	4,160	12,949	6,041	11,164	4,399	
	うち印刷関連機器	国内	4,674	1,066	4,158	1,729	4,927	1,751	2,926	1,349	4,334	874
		海外	4,635	2,336	5,725	2,307	6,204	1,783	8,371	3,907	5,869	3,182
	計	9,309	3,402	9,884	4,036	11,131	3,534	11,297	5,256	10,202	4,055	
うちプリント配線板関連機器	国内	914	486	188	408	925	329	624	204	604	167	
	海外	543	451	702	290	959	297	1,029	581	358	177	
計	1,457	937	889	698	1,884	627	1,652	785	961	344		
その他	国内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	海外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合 計	国内	12,204	11,117	16,898	18,037	19,796	21,702	14,683	23,256	12,267	14,720	
	海外	56,251	96,514	45,696	86,130	56,428	80,537	43,552	72,809	34,432	69,756	
	計	68,455	107,630	62,594	104,168	76,224	102,238	58,235	96,065	46,700	84,476	
	海外比率	82.2%	89.7%	73.0%	82.7%	74.0%	78.8%	74.8%	75.8%	73.7%	82.6%	